

IT 장비/소재

삼성전자 테일러 팹, 증설 재개 기대

SK증권 리서치센터



Analyst
이동주

natelee@sks.co.kr
3773-9026

삼성전자 23 조원 규모 파운드리 공급 계약

금일 삼성전자는 장 중 공시를 통해 글로벌 대형 기업과 23 조원 규모의 반도체 위탁 생산 공급 계약 체결을 공시했다. 계약기간은 2025 년 7 월부터 2033 년 12 월 까지다. 일론 머스크가 X 를 통해 이와 관련해서 삼성전자 테일러 팹이 AI6 칩 생산 을 담당할 것으로 언급하면서 업계에서는 테슬라향 수주로 추정하고 있다. AI6 칩은 FSD, 도조, 옵티머스까지 아우르는 차차세대용 AI 플랫폼 칩으로 성능은 5,000 TOPS 이상이 될 것으로 보인다. 본격적인 양산 시점은 2027-2028 년으로 추정 된다.

텍사스주 두번째 팹, 테일러 증설 재개 기대

미국의 칩스법 제정 이후 미국 공장 건설이 본격화되었으나 보조금 지급 지연, 제조사의 실적 악화, 인플레이션에 따른 비용 상승, 고객 부재 등으로 테일러 팹 역시 투자 지연이 거듭되었다. 트럼프 행정부에서는 기존 약속했던 투자 보조금에 대한 회의적인 시각을 드러내면서 여전히 보조금 수령에도 난항을 겪고 있는 것으로 파악된다. 이러한 가운데 삼성전자의 대규모 파운드리 수주 건은 테일러 팹 투자 재개에 기대감을 심어 주기에 충분하다. 명확한 고객이 확보된 만큼 하반기 구체적인 운영 계획이 수립될 것으로 보인다. 생산 fab, R&D 센터, 패키징 시설까지 갖춰질 예정이다. 올해 연말 인프라가 준공이 마무리되면서 원패스 물량을 시작으로 2026 년부터 본격적인 장비 입고가 시작될 것으로 예상된다.

테일러 팹 증설 관련 소부장

장비: 원익 IPS, HPSP, 피에스케이, 파크시스템스, 유니셈, 에프에스티

소재/부품: 코미코, 원익머트리얼즈, 솔브레인, 동진세미켄

후공정: 두산테스나, 네패스아크

장비 업체 중에서는 삼성전자 파운드리 베타가 큰 원익 IPS, HPSP 수혜가 클 것으로 보인다. 소재/부품에서는 미국 현지 팹을 운영 중인 업체 혹은 부지 매입을 통해 증설에 대비가 되어 있는 업체가 수혜군이며 코미코의 수혜가 클 것으로 예상된다.

삼성전자 미국 공장 현황



자료: WSJ, 중앙일보

삼성전자 미국 테일러 공장 준공



자료: 삼성전자

Compliance Notice

작성자(관리자)는 본 조사분석자료에 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 신의성실하게 작성되었음을 확인합니다.

본 보고서에 언급된 종목의 경우 당사 조사분석담당자는 본인의 담당종목을 보유하고 있지 않습니다.

본 보고서는 기관투자가 또는 제 3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

당사는 자료공표일 현재 해당기업과 관련하여 특별한 이해 관계가 없습니다.

종목별 투자의견은 다음과 같습니다.

투자판단 3 단계(6개월기준) 15%이상 -> 매수 / -15%~-15% -> 중립 / -15%미만 -> 매도

SK 증권 유니버스 투자등급 비율 (2025년 07월 28일 기준)

매수	95.60%	중립	4.40%	매도	0.00%
----	--------	----	-------	----	-------